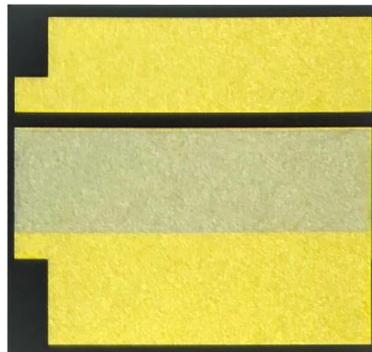
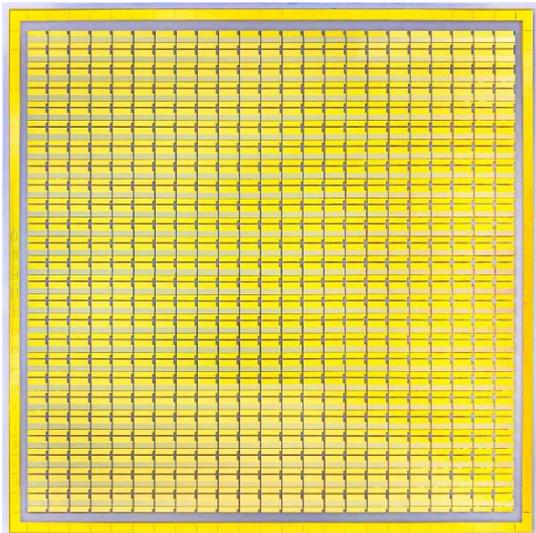


半导体高功率激光器基板



典型产品示例

氮化铝陶瓷基板

用于半导体高功率激光器芯片贴装载板，实现激光器芯片与外界良好的导热，典型参数如下：

尺寸：	按照客户要求定制；
热导率：	$> 170\text{W/m}\cdot\text{K}$ ($> 200\text{W/m}\cdot\text{K}$ 可选)；
图 形：	按照客户要求定制；
金属化：	Cu/Ni/Au, Ti/Pt/Au (或按照客户要求)
AuSn 合金：	Au80Sn20(金锡比例和厚度可按照客户要求定制)

氧化铍陶瓷基板

用于半导体高功率激光器芯片贴装载板，实现激光器芯片与外界良好的导热，典型参数如下：

尺寸：	按照客户要求定制；
热导率：	$220\sim 250\text{W/m}\cdot\text{K}$ ；
图 形：	按照客户要求定制；
金属化：	Cu/Ni/Au, Ti/Pt/Au (或按照客户要求)
AuSn 合金：	Au80Sn20(金锡比例和厚度可按照客户要求定制)